



**BUSINESS
REPORT 2013**

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジインコーポレーテッド

社長あいさつ

2013年3月期の当社グループを取り巻く環境は、米国では個人消費を中心に緩やかな景気回復が一部に見られたものの、欧州における債務問題の長期化による景気低迷や新興国の景気減速などから全般的に停滞感が強く、先行きについても依然として不透明な状況が続いております。

半導体市場につきましては、第1四半期においては在庫調整の一巡により持ち直しの動きが見られたものの、第2四半期以降、減速傾向を示していた従来型パソコンの世界出荷台数が第4四半期において大きく落ち込む等の影響を受け、一段と厳しさを増す状況となりました。一方、非半導体関連向け製品につきましては、第3四半期まで順調に推移したものの、第4四半期に入り急激に需要が減少しました。

こうした状況下、当社グループでは、非半導体関連の新規海外需要伸長により売上拡大する一方でコスト削減に努めた結果、2013年3月期の連結業績は、売上高32,412百万円（前期比18.2%増）となりました。また、利益面では、営業利益3,496百万円（前期比266.7%増）、経常利益3,843百万円（前期比270.2%増）、当期純利益2,222百万円（前期比309.1%増）となりました。

当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、半導体市場の需要減少等の影響を受けました。ラッピング材の売上高は3,037百万円（前期比2.6%増）となったものの、ポリシング材の売上高は5,935百万円（前期比14.6%減）となりました。

CMP向け製品につきましては、半導体市場の需要は低迷しているものの、最先端ロジックデバイス向け製品の販売が増加し、売上高は8,323百万円（前期比3.7%増）となりました。

ハードディスク向け製品につきましては、従来型パソコンの需要が落ち込んだものの、次世代ディスク向け製品の販売が増



加し、売上高は1,826百万円（前期比2.2%増）となりました。

非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、第4四半期に急激に減少したものの、第3四半期まで順調に推移し、売上高は11,080百万円（前期比129.0%増）となりました。

2014年3月期の見通しにつきましては、世界経済の一部に明るさが見え始めたものの半導体市場は引き続き先行き不透明な状況にあります。また、2013年3月期に大きく売上が増加した非半導体関連向け製品につきましても一部需要減少が見込まれる等、厳しい事業環境が予想されます。

当社グループはこのような事業環境の中、変化にいち早く対応することにより半導体関連事業はもとより、非半導体事業の売上拡大に向け、引き続き注力してまいります。

2013年7月
代表取締役社長

関 敬 史

プロフィール

フジインコーポレーテッドは、1950年の創業以来、分級技術などを活かした精密人造研磨材メーカーとして独自の歩みを続けてきました。蓄積されたノウハウと研究開発から生まれた製品の数々は、光学レンズ用研磨材から出発し、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP（化学的機械的平坦化）、ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっています。最近では、耐衝撃性を飛躍的に高めたサーメット溶射材やCO₂削減・省エネで注目されているLED用サファイア基板向け研磨材の商品化で新分野を開拓しています。

目次

社長あいさつ	1
当社の経営方針	3
研究開発活動	7
経営指標*	9
貸借対照表*	13
損益計算書*	15
キャッシュ・フロー計算書*	16
会社データ	17
株式情報	18

*連結での数値を記載してあります。

Message from the President

During the fiscal year ended March 31, 2013, the Fujimi Group's overall operating environment was characterized by lackluster conditions and an opaque economic outlook. The U.S. economy saw some signs of gradual recovery, centered on personal consumption, but the European economy remained sluggish due to the protracted debt crisis, and the rate of growth slowed in emerging economies.

The semiconductor market recovered somewhat in the first quarter of the year after inventory adjustments had largely run their course, but difficulties began to mount in the second quarter, and global shipments of conventional PCs, which had been trending downward, dropped sharply in the fourth quarter. Demand for non-semiconductor-related products was strong through the third quarter, but fell precipitously moving into the fourth quarter.

In this environment, the Fujimi Group put forth every effort to boost sales by leveraging new overseas demand in fields other than those related to semiconductors, as well as curtailing costs. As a result, during the fiscal year ended March 31, 2013, consolidated net sales amounted to ¥32,412 million, up 18.2% from the preceding fiscal year. Income was up sharply, with operating income rising 266.7%, to ¥3,496 million; ordinary income up 270.2%, to ¥3,843 million; and net income up 309.1%, to ¥2,222 million.

The Group's sales of its mainstay products for silicon wafers suffered from a decline in semiconductor market demand. Although sales of lapping materials grew 2.6%, to ¥3,037 million, sales of polishing compounds dropped 14.6%, to ¥5,935 million.

Despite slack demand from the semiconductor market, sales of polishing compounds for CMP increased 3.7%, to ¥8,323 million, thanks to a rise in sales of products for next-generation logic devices.

Sales of compounds for hard disks rose 2.2%, to ¥1,826 million, buoyed by sales of products for next-generation devices, although conventional PC demand slumped.

Sales of general industrial abrasives in non-semiconductor-related segments fell off significantly in the fourth quarter, but robust sales through the third quarter resulted in a 129.0% increase for the year, to sales of ¥11,080 million.

In the fiscal year ending March 31, 2014, we foresee signs of optimism in some areas of the global economy, but the outlook for the semiconductor market remains opaque. At the same time, we believe that sales of products for non-semiconductor-related applications, which grew significantly in the fiscal year ended March 31, 2013, will decline to some degree in the upcoming fiscal year, rendering the operating environment problematic.

Despite this operating environment, the Fujimi Group will continue doing its best to respond quickly to needs in the semiconductor-related business, as well as to boost sales in the non-semiconductor-related business.

July 2013

Keishi Seki, President

Profile

Since its founding in 1950, Fujimi Incorporated has continued to chart a course as a manufacturer of synthetic precision abrasives. Drawing on its accumulated expertise and extensive research and development (R&D) capabilities, the Company has expanded from abrasives for optical lenses to a variety of products that deliver the ultraprecise planarization sought by leading-edge high-tech industries. Fujimi's lineup covers the complete spectrum from compounds for silicon wafers and other semiconductor substrates, to chemical mechanical planarization (CMP) products required for multilayered circuits on semiconductor chips and compounds for hard disks. Recently, the Company is cultivating new fields, commercializing products for cermet (ceramic-metallic composite) thermal spray materials with dramatically improved impact resistance and polishing compounds for sapphire substrates used in LEDs, which are gaining attention for their role in reducing CO₂ and conserving energy.

Contents

Message from the President	2
Management Objectives	4
Research and Development Activities	8
Selected Financial Data*	9
Balance Sheets*	13
Statements of Income*	15
Statements of Cash Flows*	16
Corporate Data	17
Stock Information	18

* Indicated figures are on a consolidated basis.

当社の経営方針

はじめに

当社は「パウダーテクノロジー」を事業領域の基本として、コア技術を高め先端技術をリードすることにより、お客様の満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。「企業使命」「経営姿勢」および「行動規範」から構成される企業理念を掲げ、創業以来一貫して製品の高品質化と安定供給に努めております。

当社が創業以来持ち続ける「ものづくり」の姿勢、お客様に高品質な製品を安定提供するための努力は変わることが

ありません。ますます多様化するお客様のニーズや技術水準の高度化に対して、迅速かつ確に対応し、「顧客満足度を高める質の創造と提供」を目指した体制づくりに取り組むことにより、企業価値を高めてまいります。

また、コーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」はあらゆるステークホルダーの期待に応え、世界の人々の生活を豊かにしたいという当社の願いを表すものとして引き続き掲げてまいります。

企業理念

企業使命

高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

経営姿勢

- ・お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- ・経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- ・技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応えます。

行動規範

- ・お客様の満足を常に考え行動します。
- ・問題の本質を追求し、迅速且つ確実に解決します。
- ・夢の実現に向け、熱意・誠意・創意をもってチャレンジします。
- ・ひとりひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。
- ・良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。

企業ビジョン

事業アイデンティティ

パウダー&サーフェイス分野で世界最高技術を提供し、私たちが理想と考える「エクセレントカンパニー」を目指します。

私たちが考える「エクセレントカンパニー」とは、業績が優れているだけでなく次の3つを実現する会社です。

- ・変化に的確に対応し、未来に向けて持続的に成長する。
- ・企業理念・ビジョンの実現に向け、一人ひとりが熱意をもって、生き活きと仕事に取り組む。
- ・循環型社会の一員として環境負荷の低減に貢献する。

企業文化ビジョン

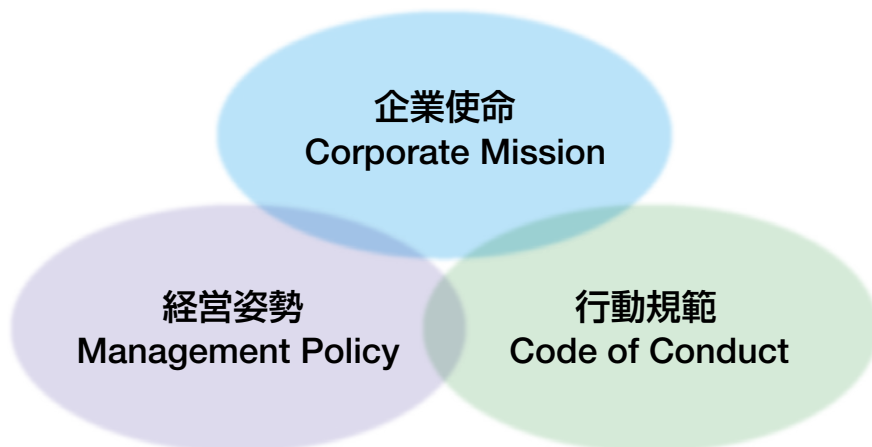
強く、やさしく、面白い会社を目指します。

- ・自由闊達で切磋琢磨する風土をつくります。(強く)
- ・仲間を大切に、助け合い、感謝します。(やさしく)
- ・夢をいだき、夢がかなう職場をつくります。(面白い)

事業構造ビジョン

既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野(シリコン・CMP)と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します。

企業理念 Corporate Philosophy



Management Objectives

Introduction

Fujimi has endeavored to earn the trust of and further satisfy its customers by advancing its leading-edge core technologies, centered on its base in powder technologies. In line with our corporate philosophy, which comprises our Corporate Mission, Management Policy and Code of Conduct, we continue in our efforts to consistently deliver a stable supply of high-quality products—a cornerstone of our business.

Since our establishment, we have worked persistently to provide our customers with a stable supply of high-quality

products, a manufacturing approach from which we have never wavered. We aim to increase corporate value by swiftly and accurately meeting the diverse needs of customers with sophisticated technologies. To enhance corporate value, we are conducting organizational initiatives designed to create and deliver quality that will satisfy our customers.

To meet all our expectations, our corporate slogan, “polishing our technologies and bringing people together,” which expresses our desire to provide the people of the world with a rich lifestyle, will remain the same.

Corporate Philosophy

Mission Statement

Our mission is to develop new, innovative technologies and applications with a commitment to environmental sustainability, thereby enabling the advancement of technology for the betterment of humanity.

Management Philosophy

- We adopt the customer's point of view to create solutions that meet the customer's needs and expectations.
- We excel in the ever changing business environment through innovation and continuous improvement.
- We adhere to rules and regulations and operate ethically, thereby strengthening our stakeholders' confidence and trust.

Code of Conduct

- We act with customer satisfaction in mind.
- We strive to identify the cause of an obstacle and to resolve it quickly.
- We challenge ourselves to succeed with passion, sincerity and creativity.
- We respect each person's ideas.
- We conduct ourselves with pride, honesty and integrity.

Corporate Vision

Business Identity

We offer the world's highest level of technology in the powder and surface fields, and aim to be an “excellent company.”

Being an “excellent company” means not only having excellent results. It also includes the following.

- Respond to change precisely, and grow continuously.
- Each person works eagerly to achieve the corporate philosophy and vision.
- Contribute to decreasing the environmental impact as a member of a recycling-based society.

Corporate Cultural Vision

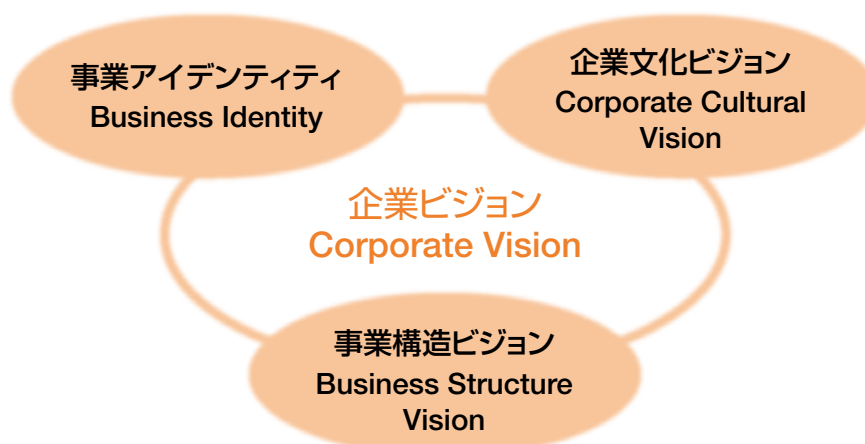
Fujimi will be a strong, kind and exciting company.

- Arrange to work hard with a free and broad mind. (Strong)
- Be nice, cooperative and appreciative to colleagues. (Kind)
- Have a future plan, and form individual working groups to achieve such plan. (Exciting)

Business Structure Vision

Fujimi will strengthen its existing businesses while aggressively taking on challenges in new fields. We will construct a stable business that is balanced between the semiconductor (Silicon and CMP) and non-semiconductor fields.

企業ビジョンの構成 Structure of the Corporate Vision



中長期的な会社の経営戦略

当社はバランス・スコアカード（BSC）の考え方を基に、2009年6月に2018年3月期を最終年度とする中長期経営計画を策定いたしました。この中長期経営計画は、3年を区切りとする3次の中期計画を基にして、数値的な定量的な計画だけでなく当社のありたい姿を含めた定性的な計画としています。

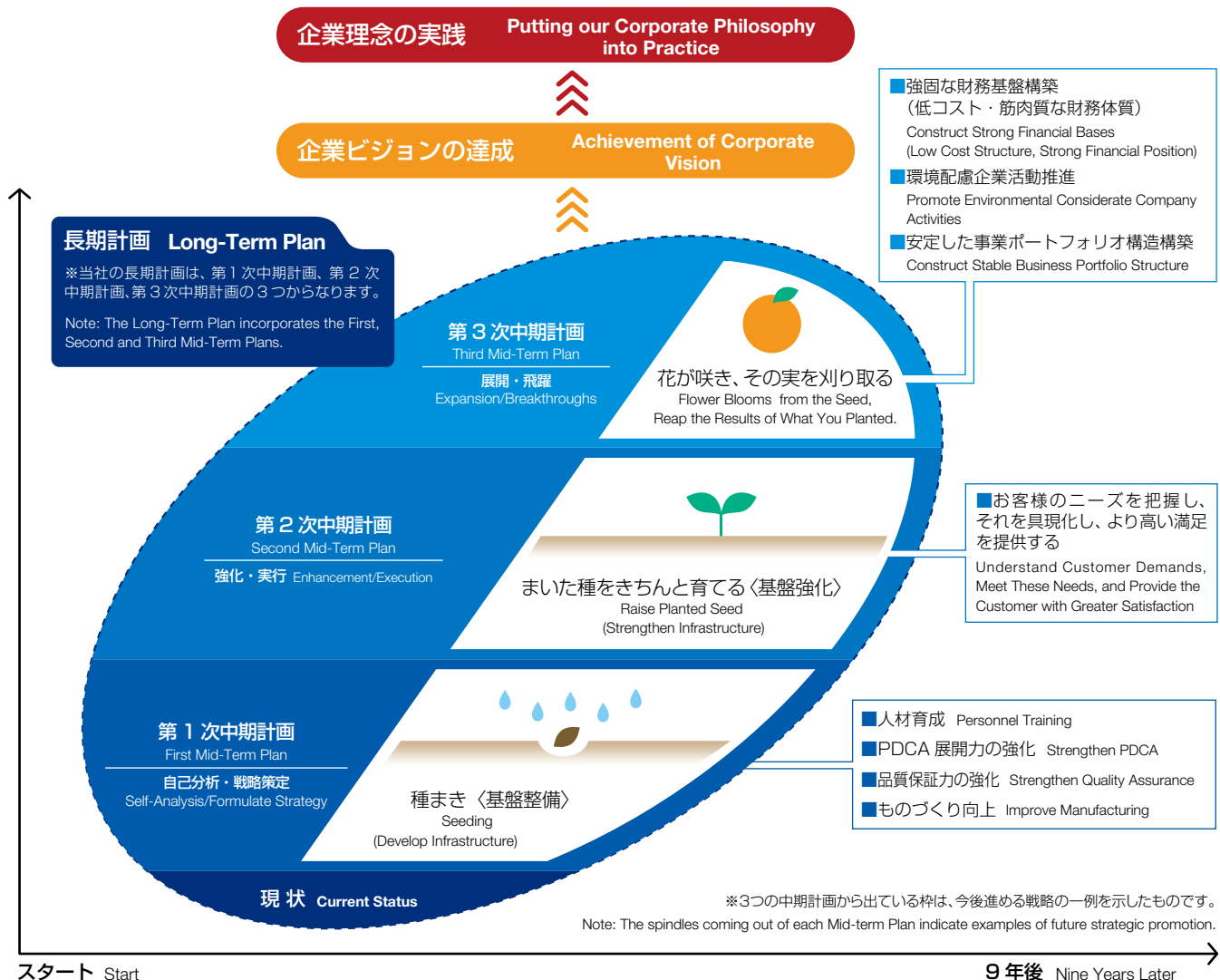
中期計画の第一段階は自己診断と成長のための基礎体力づくり、成長のための種まきにあて、第二段階はまいた種をきちんと育てる時期、そして第三段階は事業開花させ、実を収穫する時期、とそれぞれ位置づけています。

中長期計画の4年目のあたる当期は、第2次中期計画の「まいた種をきちんと育てる〈基盤強化〉」の時期に相当し、お客様のニーズを把握し、それを具現化し、より高い満足を提供することに注力してまいります。

今後当社は、経済環境の変化のなかでアグレッシブな成長を目指し、積極果敢にチャレンジしなければならないと考えております。それに加えてどのような景気変動下にあっても安定的な成長を遂げるため、特定の事業や用途に偏ることがない事業構

造が必要と考えております。そのため従来から推進しているシリコン・CMP・ディスク・機能材・溶射材の5事業に加え、新規事業と新たな用途の探索に継続的にチャレンジし、その実現に向けさまざまな可能性を含めた検討を進めることとしました。具体的には、(1)ろ過・分級、(2)砥粒、(3)ケミカルの3つのコア技術を中心に、技術開発を進め、商品開発の加速、事業のさらなる拡大を推進しております。また、営業と開発を一体化し、市場やお客様のニーズにより迅速かつ確にお応えできるよう組織を再編いたしました。このことを通じて安定した事業構造を維持するため、将来的には事業構造比率として半導体関連比率50%、非半導体関連比率50%を目指しております。

また、全社レベルの目標を事業ごとに戦略目標、施策として具現化し、その成果については評価指標（KPI）によって四半期ごとに進捗管理するなど、明確な責任体制のもと事業戦略を組織横断的に展開しております。



Mid-Long Term Management Strategy

Based on its core concept of a Balanced Scorecard (BSC), Fujimi has formulated a Mid-Long Term Management Plan to guide the Company from June 2009 through the fiscal year ending March 31, 2018. The plan is separated into three parts and is based on three successive mid-term plans. In addition to quantifiable objectives, the plan includes qualitative elements that describe the type of organization Fujimi aims to become.

The first stage of our mid-term plan involves self-analysis and establishing the foundations for growth—"seeding" our operations. The second stage involves raising the planted seeds, and at the third stage we plan to reap the results of the seeds of progress we have planted.

Now in the fourth year of our Mid-Long Term Management Plan, we are in the second phase, of raising the seeds we have planted (strengthening infrastructure). In this phase, we will concentrate on understanding customers' needs, satisfying these needs, and providing the customer with greater satisfaction.

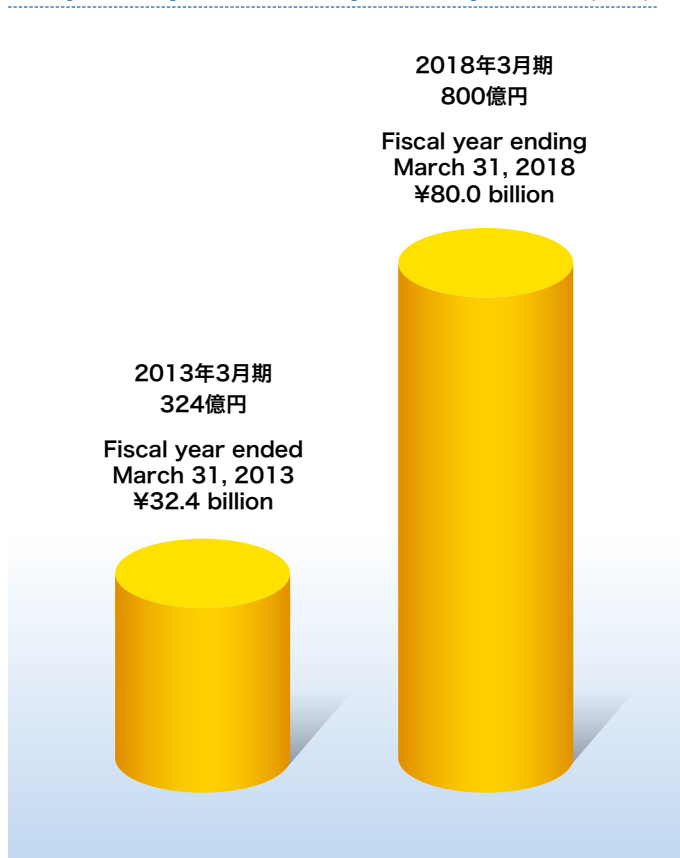
Fujimi understands that achieving its aggressive growth targets in a changing economic environment will require it to take a proactive stance toward upcoming challenges. Furthermore, ensuring stable growth under fluctuating business conditions requires the Company to adjust its business structure along

the lines of specific businesses and applications. For this reason, we will continue our search for new businesses and applications in addition to the five areas we have pursued to date (Silicon, CMP, Disk, Specialty Materials and Thermal Spray Materials). We established a specialized section concentrating mainly on three core technologies involving (1) filtration and classification, (2) abrasives and (3) chemicals, for promoting technological development, accelerating product development and targeting further business expansion in these areas. Furthermore, we reorganized our business to achieve greater integration between sales and development and enable us to respond more quickly to market demands and the needs of our customers.

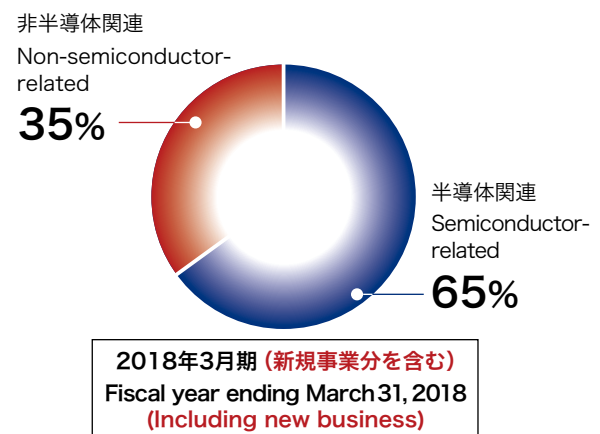
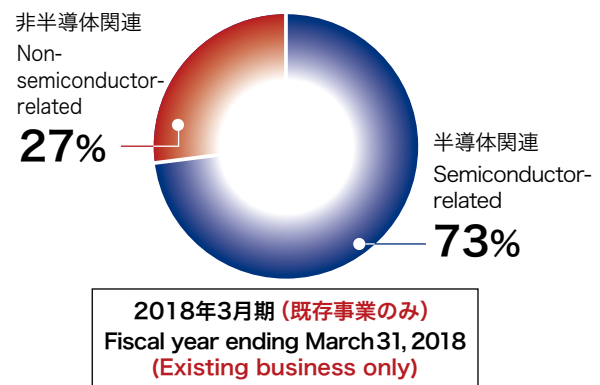
Through these efforts, we aim to achieve a business structure in which 50% of our revenues come from semiconductor-related businesses and 50% from non-semiconductor-related businesses.

On a companywide level, we have established strategic targets for the five businesses, by creating specific measures and defining key performance indicators to monitor progress on a quarterly basis. We are deploying operational strategies across the organization, based on a system of clearly defined responsibilities.

中長期経営計画経営目標 (売上高)
Management Targets of the Mid-Long Term Management Plan (Sales)



事業構造ビジョン (売上構成比)
Business Structure Vision (Composition of Sales)



研究開発活動

当社は、超精密研磨のリーディングカンパニーとして、常に先端電子産業を支えるべく、シリコンウェハー、半導体デバイス、ハードディスクをはじめとする、さまざまな電子部品の研磨・研削材の開発に積極的に取り組んでいます。

また、溶射材の開発、当社成長のコアとなる基盤技術開発機能の充実、技術に基づいた新規事業・新規テーマの調査企画機能の強化に努めています。

シリコンウェハー

シリコンウェハー 300mm の需要拡大、デザインルールの超微細化に伴い、超精密研磨の要件である、①平坦化、②無欠陥化、

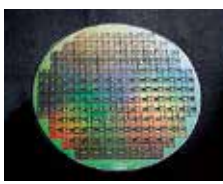


③平滑化、④汚染低減、⑤生産性向上への要求はますます強くなっています。平坦化と生産性向上が求められている、ラッピング材やシリコンウェハー切断用研磨材では、加工精度と加工歩留まり向上のために、砥粒の細粒化に注力しています。

最終仕上げに用いられるポリシング材では、無欠陥化、平滑化、汚染低減への要求がますます強くなっています。22nm デバイス世代のウェハー研磨用として、研磨後表面のナノ欠陥を激減させるポリシング材や、原子レベルの平滑性を実現するポリシング材の開発を推進しています。また、一次研磨工程ではウェハー中心部から外周部まで超平坦に加工できるポリシング材や、生産性向上につながる高速ポリシング材にも、砥粒・添加剤技術を応用しながら開発に取り組んでいます。

デバイス CMP

先端の半導体デバイスの微細化はとどまるところを知らず、テクノロジーノード22nm の量産とともに14nm 以降のデバイスの研究開発が進んでいます。



微細化の進展に伴い、Fin FET と呼ばれる新しい3次元構造のトランジスタが開発、量産されています。また、高密度化を目的に3次元にLSIを積層する、スルーシリコンビア(TSV)技術の開発も進んでいます。これらの新トランジスタやTSVの形成においてもCMPプロセスの適用が検討されており、その範囲がますます広がりつつあります。

当社では、従来の多結晶シリコン薄膜用やCu配線用にポリシング材を開発していますが、上記のようなCMPプロセスの用途の拡大に合わせ、Fin FET トランジスタ用、TSV用などにおいて新たな研磨対象となる材料や構造に適用できるポリシング材の開発も始めています。当社では微細化、高密度化とともに高度化する顧客要求に応えるため、最先端の研磨装置、評価装置を活用すると同時に、当社の砥粒技術、ケミカル技術などを活かした研究開発を行っています。

ハードディスク

今後増大していくデジタルデータの要求量に対応するために、次世代ハードディスクの開発が加速しています。現在、ハードディスク基盤に求められる欠陥数・サイズの低減要求はさらに厳しくなっており、数nmレベルの欠陥が問題とされています。



本要求に応えるべく、お客様と一体となった活動を実施し新商品の開発を推進しています。

機能材

新規事業として、LED・パワーエレクトロニクス・その他一般工業用部品の表面加工分野や、パウダー技術を活かした応用分野への展開に積極的に取り組んでいます。

環境・エネルギー産業分野では、LEDやパワーエレクトロニクス用部品の需要が急増しています。CO2削減や省エネで注目を浴びるLED用サファイア基板や、次世代パワーエレクトロニクス用として期待されているGaN・SiC基板は、極めて硬質なために加工に膨大な時間を要しており、製造コスト削減のために加工速度の向上が切望されています。これら硬脆材料基板にダメージを与えることなく、高効率な加工を実現する、研磨・研削材の開発を推進しています。

その他一般工業用分野では、金属、ガラス、セラミックス、樹脂などの産業を支える多種多様な各種部品の表面加工材料の開発を推進しています。また、角状ナノアルミナなど、パウダーの特徴を活かした機能材料、光学レンズ用の研削材の開発にも取り組んでいます。

開発企画部門では、当社のコア技術が展開可能な新規分野を、技術と市場の両視点から探索し、新規商品・新規開発テーマの企画を推進しています。

基盤技術・生産技術

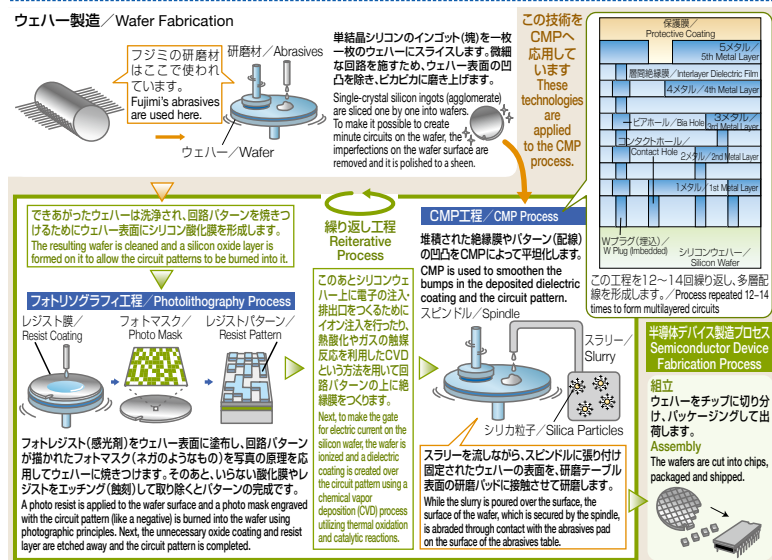
基盤技術・生産技術部門では当社コア技術のさらなる強化に努めています。①ろ過・分級・精製、②パウダー、③ケミカルの3つのコア技術を中心に技術開発を進め、商品開発の加速、高性能化、新規事業分野への展開に貢献しています。

溶射材

省資源化、高効率化要求が高まっている現代社会において、航空機、半導体、一般産業機械など多岐にわたり高性能皮膜の要求は高まってきており、溶射皮膜の用途拡大が見込まれています。近年の溶射プロセスでも、高効率化、高品質化へ向け、低温化、微粉化をキーワードとした新技術が注目を集めています。これら市場の期待に応えるべく、新技術に最適な溶射材開発に重点を置き推進しています。



半導体デバイス製造におけるCMPの役割 Role of CMP Processes in Semiconductor Device Fabrication



Research and Development Activities

As the leading name in synthetic precision abrasives, Fujimi supports the advanced electronic industry through its aggressive development of polishing and abrasive compounds for various electronic components, such as silicon wafers, semiconductor devices and hard disks. Also, we are seeking to enhance the development of thermal spray materials and the fundamental technology development function, which is core to our growth. We are working to strengthen our technology-based new business and topics research and planning function.

Silicon Wafer Compounds

In accordance with rising demand for 300mm silicon wafers and shrinking design rules, demand is increasing for synthetic precision abrasives that are (1) flat, (2) free from defects and (3) smooth, and that (4) minimize contamination from trace metals and (5) improve manufacturing. We are focused on abrasive grain refinement to improve the processing accuracy and yield rate for lapping and silicon wafer slicing abrasives, which are also required for high-performance flatness and improved manufacturing.

The demand for flat, defect-free, smooth and uncontaminated polishing compounds used in the finishing process are growing stronger. We are developing polishing compounds that will reduce nano defects and achieve the level of smoothness required in polishing next-generation wafers for 22nm devices, as well as polishing compounds that achieve atomic level smoothness. Fujimi is also engaged in the development of abrasives and additive technologies for high-speed polishing compounds, which are linked with productivity increases.

Device CMP

There is no end to the micronization of cutting-edge semiconductor devices, as 22 nm technology nodes are now being mass-produced, and research and development is moving forward towards 14 nm and smaller devices. Alongside the micronization trend, a new kind of transistor with a 3D structure, known as a FinFET, has been developed and taken to production. And, with a goal of higher densification, development of Through Silicon Via (TSV) technology that laminates LSIs in 3 dimensions is underway. We are exploring the application of CMP processing to these new transistors and TSV forming with the strong prospect of expanding its scope.

We have already developed polishing materials for polycrystalline silicon films and Cu wiring, but for the expanded use of CMP processing as aforementioned, we have launched research into polishing materials that can be used with new materials and structures for FinFET transistors, TSV and so forth. At Fujimi, we are employing state-of-the-art polishing and evaluating equipment, and applying proprietary polishing and chemical technologies to research and development operations in order to meet customer demands for higher levels of micronization, densification and sophistication.

Compounds for Hard Disks

Development of next generation hard disks has accelerated in order to handle the increased volume of digital data of the coming future. Today, demands for fewer and smaller defects are even stricter with hard disk substrates, as defects of just several nm in size are considered a problem. To meet these requirements, we are working on new product development through activities together with customers.

Specialty Materials

As new areas of business, we are aggressively working to extend our surfacing technologies to LEDs, power electronics components and general industrial parts, and to expand the application of our powder technologies.

In environmental and energy fields, demand for LEDs and power electronics components is surging. The sapphire substrates used for LEDs, which are being heralded for their CO₂ reduction and energy-saving effects, and gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC) substrates that are anticipated to play a key role in the next generation of power electronics require a great amount of time to process because they are extremely hard. Improvements to processing speed are strongly desired as they would help to reduce manufacturing costs. At Fujimi, we are, therefore, promoting development of abrasive and polishing compounds that allow these hard brittle materials to be processed in a highly efficient manner without damage.

In general industrial fields, we are developing surfacing compounds for use with a wide range of materials that support industry, such as metal, glass, ceramics, resin and more. We are also developing functional materials like angular nano alumina that takes advantage of the powder characteristics, and abrasive materials for polishing optical lenses.

In planning new products and development themes, our R&D planning section is searching for new fields where we can apply our core technologies from both the perspective of technologies and markets.

Core Technologies, Production Technologies

This section focuses on reinforcing Fujimi's strengths in core technologies. By promoting the development of technologies mainly involving (1) filtration and classification, (2) abrasives and (3) chemicals, the section will accelerate product development, target greater functionality and help expand the Company's operations into new fields of business.

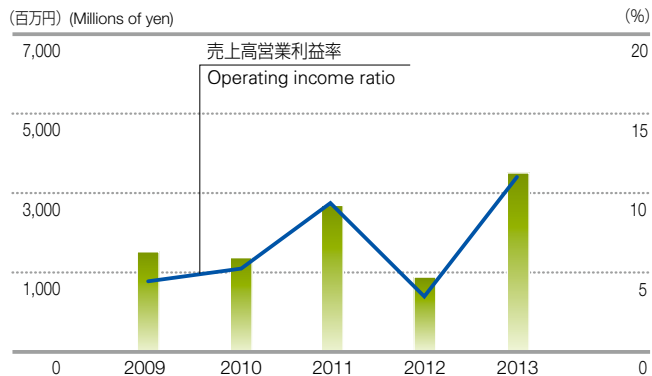
Thermal Spray Materials

In today's world of increasing demand for resource conservation and higher efficiency, there is growing need for highly functional films across a wide range of products such as aircraft, semiconductors and general industrial equipment, thus broader use of thermal spray films is anticipated. In recent years, attention has turned to new technologies where the keywords are lower temperatures and micronization, as a means for enhancing the efficiency and quality of thermal spray processing. In a move to meet these market expectations, we are stepping up our development of thermal spray materials appropriate for these new technologies.

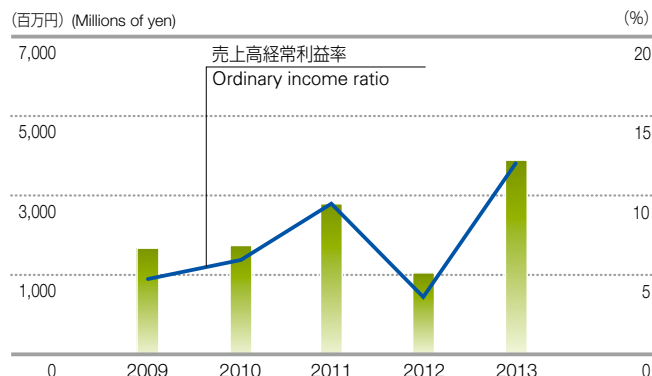
経営指標 Selected Financial Data

収益性 Profitability

営業利益/売上高営業利益率
Operating Income and Operating Income Ratio



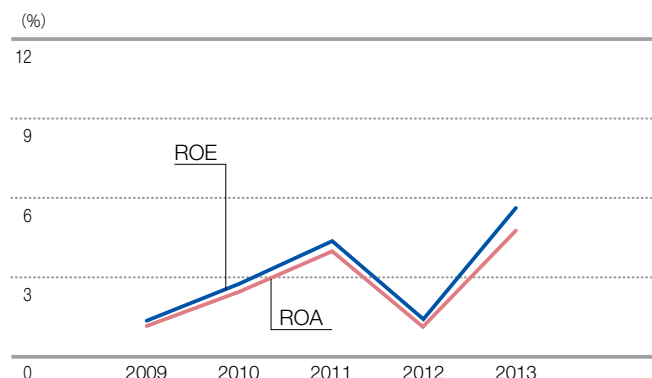
経常利益/売上高経常利益率
Ordinary Income and Ordinary Income Ratio



当期純利益/売上高当期純利益率
Net Income and Return on Sales



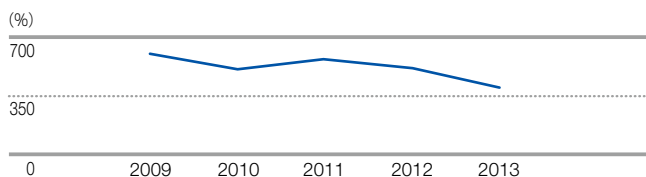
自己資本当期純利益率/総資産利益率
Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)



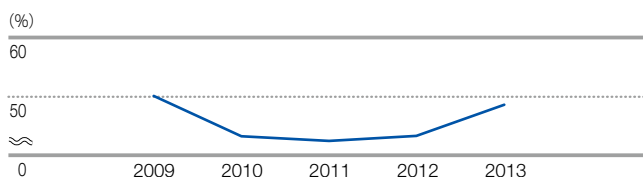
Fiscal years ended March 31				平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期
				2009	2010	2011	2012	2013
売上高	(百万円)	Net sales	(Millions of yen)	34,122	28,177	30,869	27,424	32,412
営業利益	(百万円)	Operating income	(Millions of yen)	1,547	1,496	2,777	953	3,496
売上高営業利益率	(%)	Operating income ratio	(%)	4.5	5.3	9.0	3.5	10.8
経常利益	(百万円)	Ordinary income	(Millions of yen)	1,645	1,699	2,817	1,038	3,843
売上高経常利益率	(%)	Ordinary income ratio	(%)	4.8	6.0	9.1	3.8	11.9
当期純利益	(百万円)	Net income	(Millions of yen)	600	1,161	1,820	543	2,222
売上高当期純利益率	(%)	Return on sales	(%)	1.8	4.1	5.9	2.0	6.9
自己資本当期純利益率 (ROE)	(%)	Return on equity	(%)	1.4	2.8	4.4	1.4	5.6
総資産利益率 (ROA)	(%)	Return on assets	(%)	1.2	2.5	3.9	1.2	4.7

安定性 Stability

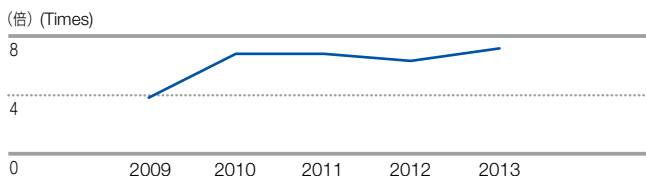
流動比率 Current Ratio



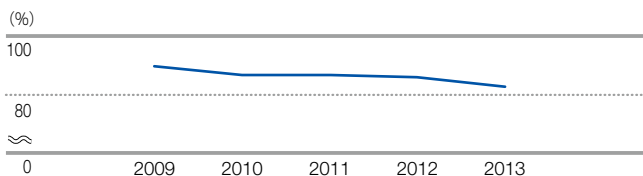
固定比率 Fixed Assets Ratio



手元流動性比率 Short-Term Liquidity



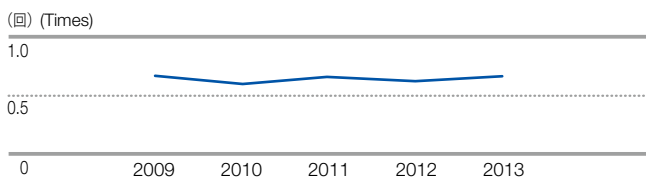
自己資本比率 Equity Ratio



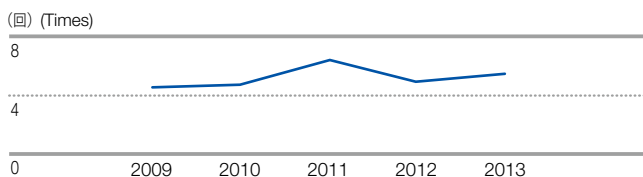
Fiscal years ended March 31				平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013
流動比率	(%)	Current ratio	(%)	606.6	513.8	531.9	516.1	395.1
固定比率	(%)	Fixed assets ratio	(%)	50.2	43.3	40.3	41.4	42.6
手元流動性比率	(倍)	Short-term liquidity	(Times)	3.9	6.9	6.9	6.5	7.1
自己資本比率	(%)	Equity ratio	(%)	89.7	86.7	86.7	86.4	83.1

生産性 / 効率性 Productivity and Efficiency

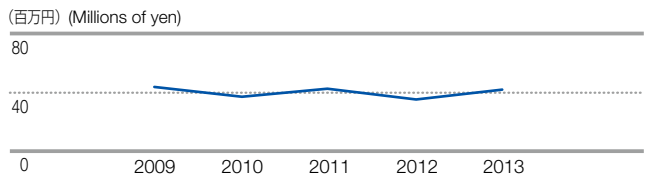
総資産回転率 Asset Turnover



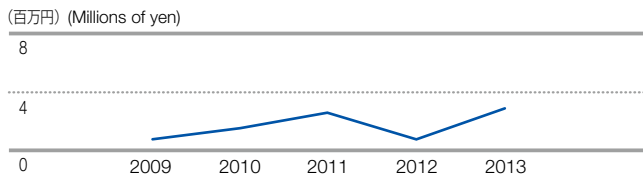
たな卸資産回転率 Inventory Turnover



従業員1人当たり売上高 Net Sales per Employee



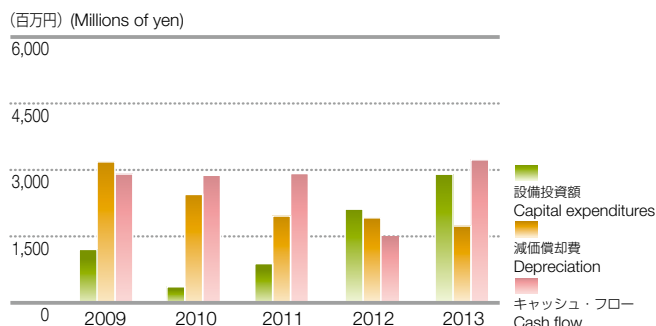
従業員1人当たり当期純利益 Net Income per Employee



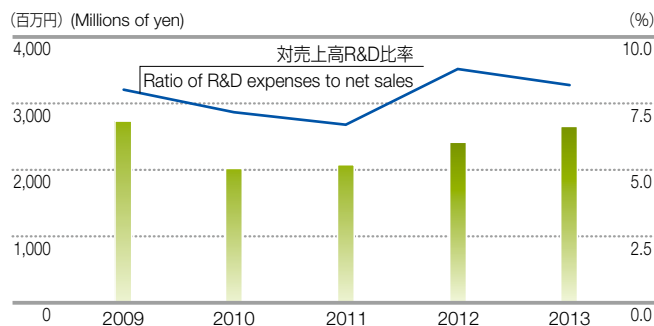
Fiscal years ended March 31				平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013
総資産回転率	(回)	Asset turnover	(Times)	0.67	0.60	0.66	0.62	0.66
たな卸資産回転率	(回)	Inventory turnover	(Times)	4.55	4.73	6.35	4.86	5.36
従業員1人当たり売上高	(百万円)	Net sales per employee	(Millions of yen)	44.00	37.29	41.77	36.08	41.39
従業員1人当たり当期純利益	(百万円)	Net income per employee	(Millions of yen)	0.77	1.53	2.46	0.71	2.84
従業員数	(人)	Number of employees		775	736	742	760	783

設備投資 / 研究開発 Capital Expenditures / Research and Development

設備投資額/減価償却費/キャッシュ・フロー Capital Expenditures, Depreciation and Cash Flow



研究開発費/対売上高R&D比率 R&D Expenses and Ratio of R&D Expenses to Net Sales



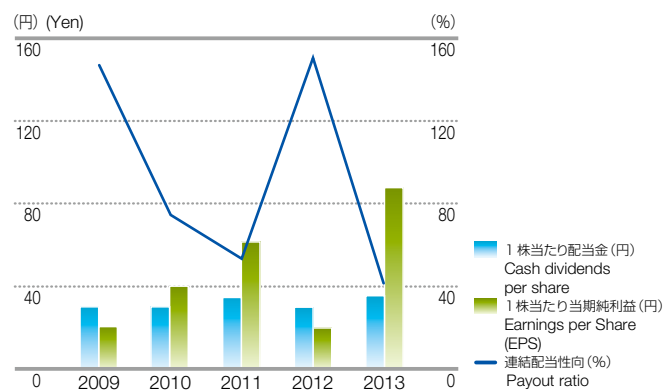
		平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期
		2009	2010	2011	2012	2013
Fiscal years ended March 31						
設備投資額	(百万円) Capital expenditures (Millions of yen)	1,207	363	905	2,116	2,856
減価償却費	(百万円) Depreciation (Millions of yen)	3,183	2,448	1,991	1,921	1,713
キャッシュ・フロー * 1	(百万円) Cash flow (Millions of yen)	2,909	2,880	2,949	1,492	3,157
研究開発費	(百万円) R&D expenses (Millions of yen)	2,738	2,025	2,109	2,415	2,638
対売上高 R&D 比率	(%) Ratio of R&D expenses to net sales (%)	8.03	7.19	6.83	8.80	8.14

* 1 キャッシュ・フロー = 当期純利益 + 減価償却費 - 配当金

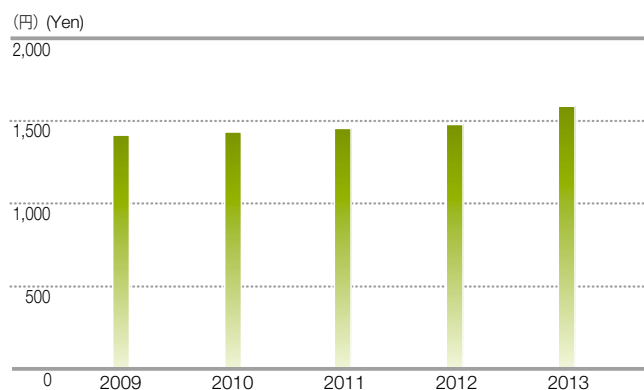
Note: Cash flow = Net income + Depreciation - Dividends

投資指標 Per Share Data and Others

1株当たり配当金/連結配当性向 Cash Dividends per Share, Payout Ratio 1株当たり当期純利益 Earnings per Share (EPS)



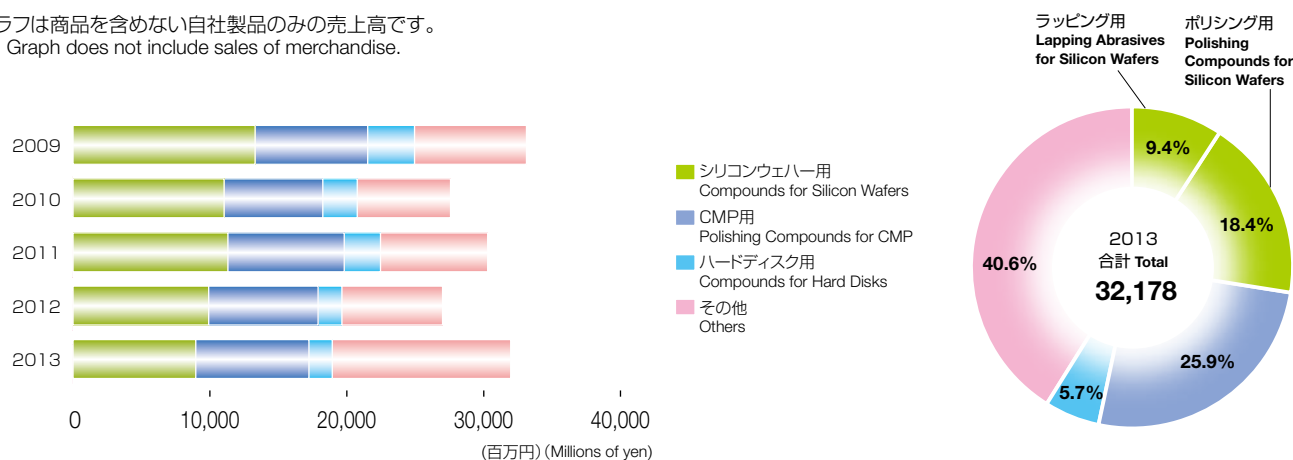
1株当たり純資産 Book Value per Share (BPS)



		平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期
		2009	2010	2011	2012	2013
Fiscal years ended March 31						
1株当たり配当金	(円) Cash dividends per share (Yen)	30.00	30.00	35.00	30.00	35.00
連結配当性向	(%) Payout ratio (%)	146.8	75.0	54.8	150.7	40.9
1株当たり当期純利益 (EPS)	(円) Earnings per share (Yen)	20.44	39.98	63.82	19.91	85.68
1株当たり純資産 (BPS)	(円) Book value per share (Yen)	1,413.55	1,432.59	1,450.83	1,478.56	1,579.79

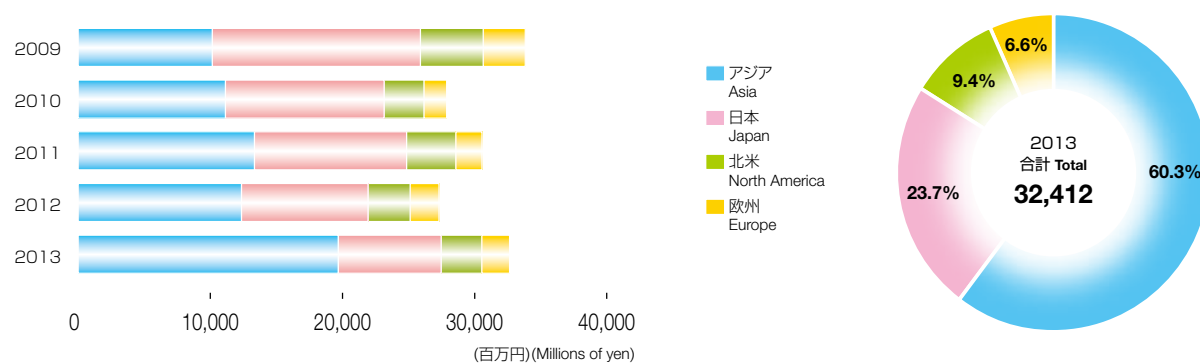
用途別製品売上高 Sales by Application

* グラフは商品を含めない自社製品のみでの売上高です。
Note: Graph does not include sales of merchandise.



Fiscal years ended March 31 (百万円) (Millions of yen)		平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013
シリコンウェハー用	Compounds for Silicon Wafers	13,296	11,037	11,314	9,907	8,973
CMP用	Polishing Compounds for CMP	8,266	7,262	8,532	8,029	8,323
ハードディスク用	Compounds for Hard Disks	3,469	2,570	2,689	1,788	1,826
その他	Others	8,265	6,854	7,868	7,388	13,054

地域別売上高 Sales by Region



Fiscal years ended March 31 (百万円) (Millions of yen)		平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010	平成23年3月期 2011	平成24年3月期 2012	平成25年3月期 2013
アジア	Asia	10,238	11,256	13,469	12,389	19,542
日本	Japan	15,838	12,076	11,579	9,568	7,696
北米	North America	4,843	3,126	3,829	3,282	3,046
欧州	Europe	3,202	1,718	1,990	2,183	2,127
合計	Total	34,122	28,177	30,869	27,424	32,412

貸借対照表

Balance Sheets

(百万円) (Millions of yen)

As of March 31		平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013
資産の部	Assets					
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and cash equivalents	10,095	13,835	12,468	9,490	14,023
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable	5,912	8,027	6,820	6,504	6,021
有価証券	Marketable securities	103	2,303	5,303	5,301	5,109
たな卸資産	Inventories	7,244	4,676	5,048	6,241	5,856
繰延税金資産	Deferred tax assets	236	751	632	434	610
短期貸付金	Short-term loans receivable	802	2	3	4	3
その他の流動資産	Other current assets	1,062	130	276	570	282
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(197)	(110)	(157)	(41)	(31)
流動資産合計	Total current assets	25,260	29,617	30,396	28,506	31,877
固定資産	Fixed assets					
有形固定資産	Tangible fixed assets					
建物及び構築物	Buildings and structures	8,297	7,568	6,963	6,782	8,197
機械装置及び運搬具	Machinery and equipment	4,496	3,181	2,345	2,062	2,130
土地	Land	3,428	3,400	3,391	3,392	3,402
その他の有形固定資産	Other tangible fixed assets	1,462	1,088	1,218	1,732	1,715
有形固定資産合計	Total tangible fixed assets	17,685	15,239	13,919	13,970	15,445
無形固定資産	Intangible fixed assets	363	331	305	462	608
投資その他の資産	Investments and other assets					
投資有価証券	Investment in securities	184	253	98	99	115
長期貸付金	Long-term loans receivable	1	1	3	4	2
繰延税金資産	Deferred tax assets	360	82	95	48	18
その他の投資その他の資産	Other investments and assets	2,121	1,954	1,925	1,488	1,467
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(8)	(16)	(9)	(199)	(198)
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	2,659	2,273	2,113	1,442	1,406
固定資産合計	Total fixed assets	20,708	17,844	16,338	15,875	17,460
資産合計	Total assets	45,969	47,462	46,734	44,381	49,337

(百万円) (Millions of yen)

As of March 31		平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013
負債の部	Liabilities					
流動負債	Current liabilities					
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable	2,414	3,335	2,905	3,082	3,173
短期借入金	Short-term borrowings	145	184	81	41	—
未払法人税等	Corporate tax payable	76	476	476	14	1,605
賞与引当金	Allowance for bonuses payable	368	456	595	612	679
その他の流動負債	Other current liabilities	1,159	1,310	1,655	1,773	2,610
流動負債合計	Total current liabilities	4,164	5,763	5,714	5,523	8,068
固定負債	Fixed liabilities					
長期借入金	Long-term borrowings	250	161	61	—	—
退職給付引当金	Allowance for employees' retirement benefits	85	98	120	147	172
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	7	5	8	33	31
その他	Other fixed liabilities	9	5	27	32	34
固定負債合計	Total fixed liabilities	352	271	217	214	238
負債合計	Total liabilities	4,517	6,035	5,932	5,737	8,307
純資産の部	Net assets					
資本金	Common stock	4,753	4,753	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	Capital surplus	5,070	5,069	5,069	5,069	5,069
利益剰余金	Retained earnings	34,679	35,111	36,069	35,716	37,160
自己株式	Treasury stock	(2,104)	(2,764)	(3,792)	(5,711)	(5,711)
株主資本合計	Total shareholders' equity	42,398	42,170	42,100	39,828	41,272
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income	(1,162)	(998)	(1,565)	(1,475)	(294)
新株予約権	Subscription rights to shares	44	63	61	59	52
少数株主持分	Minority interests	172	191	205	231	—
純資産合計	Total net assets	41,451	41,426	40,802	38,643	41,030
負債純資産合計	Total liabilities and net assets	45,969	47,462	46,734	44,381	49,337

損益計算書

Statements of Income

(百万円) (Millions of yen)

		平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年
		3月期	3月期	3月期	3月期	3月期
Fiscal years ended March 31		2009	2010	2011	2012	2013
経常損益の部	Ordinary income and expenses					
営業損益の部	Operating income and expenses					
売上高	Net sales	34,122	28,177	30,869	27,424	32,412
売上原価	Cost of sales	25,178	20,573	21,362	19,399	21,116
売上総利益	Gross profit	8,943	7,604	9,506	8,024	11,295
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	7,396	6,107	6,729	7,070	7,798
営業利益	Operating income	1,547	1,496	2,777	953	3,496
営業外損益の部	Non-operating income and expenses					
受取利息	Interest income	90	50	54	60	70
受取配当金	Dividend income	4	2	2	2	2
その他の営業外収益	Other nonoperating income	87	174	68	72	323
営業外収益	Non-operating income	183	225	125	136	396
支払利息	Interest expenses	47	16	12	5	0
固定資産除売却損	Loss on disposal of fixed assets	—	—	—	—	34
その他の営業外費用	Other nonoperating expenses	37	6	72	46	15
営業外費用	Non-operating expenses	85	22	85	51	50
経常利益	Ordinary income	1,645	1,699	2,817	1,038	3,843
特別損益の部	Extraordinary items					
固定資産売却益	Proceeds from sales of fixed assets	3	1	3	2	—
補助金収入	Subsidy income	36	—	—	—	—
その他の特別利益	Other extraordinary income	18	219	51	3	6
特別利益	Extraordinary income	58	220	54	6	6
固定資産除売却損	Loss on disposal of fixed assets	54	45	65	15	—
投資有価証券評価損	Loss on revaluation of investment securities	30	—	22	0	—
減損損失	Impairment loss	90	403	—	—	—
その他の特別損失	Other extraordinary losses	136	3	19	48	—
特別損失	Extraordinary losses	312	452	107	63	—
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes	1,392	1,467	2,764	980	3,849
法人税、住民税及び事業税	Income taxes—current	304	546	828	157	1,754
法人税等調整額	Income taxes—deferred	448	(255)	97	260	(152)
少数株主利益	Minority interest in earnings of consolidated subsidiaries	38	14	17	19	25
当期純利益	Net income	3,249	600	1,820	543	2,222

キャッシュ・フロー計算書

Statements of Cash Flows

(百万円) (Millions of yen)

		平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期
Fiscal years ended March 31		2009	2010	2011	2012	2013
営業活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from operating activities					
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes	1,392	1,467	2,764	980	3,849
減価償却費	Depreciation and amortization	3,183	2,448	1,991	1,921	1,713
減損損失	Impairment loss	90	403	—	—	—
固定資産除売却損益 (益)	Loss (gain) on sale or disposal of fixed assets	50	43	62	12	34
売上債権増減額 (増加)	(Increase) decrease in receivables	5,777	(2,081)	1,036	130	697
仕入債務増減額 (減少)	Increase (decrease) in payables	(2,140)	856	(289)	26	(89)
たな卸資産増減額 (増加)	(Increase) decrease in inventories	(359)	2,656	(561)	(1,161)	644
その他	Others	(250)	149	110	86	557
小計	Subtotal	7,743	5,944	5,115	1,996	7,407
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends received	89	51	68	64	66
補助金の受取額	Income from new industry subsidies	33	99	—	—	—
事業撤退に伴う収入	Income from withdrawal from business	—	32	—	—	—
事業撤退による支出	Payments for withdrawal from business	(17)	—	—	—	—
利息の支払額	Interest paid	(48)	(16)	(13)	(5)	(0)
法人税等の支払額	Income taxes paid	(1,814)	(135)	(837)	(892)	(233)
法人税等の還付額	Income taxes refunded	—	791	9	—	345
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash and cash equivalents provided by operating activities	5,986	6,768	4,342	1,162	7,585
投資活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from investing activities					
定期預金の預入による支出	Payments for additions to fixed deposits	—	(1,500)	(1,505)	(2,615)	(3,017)
定期預金の払戻による収入	Income from withdrawal of fixed deposits	800	150	1,500	2,508	2,912
有価証券の増減額 (減少)	(Increase) decrease in marketable securities	—	99	108	—	—
有価証券の取得による支出	Payment for acquisition of securities	—	—	—	(800)	(3,106)
有形固定資産取得による支出	Purchase of tangible fixed assets	(2,382)	(256)	(508)	(1,707)	(2,370)
その他	Others	8	(87)	(65)	(262)	677
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash and cash equivalents used in investing activities	(1,573)	(1,594)	(471)	(2,876)	(4,904)
財務活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from financing activities					
短期借入金の純増減額 (減少)	Increase (decrease) in short-term borrowings	(487)	37	(87)	—	—
長期借入金の返済による支出	Expenses from repayment of long-term borrowings	(106)	(93)	(87)	(79)	(41)
自己株式の取得及び売却による収支	Proceeds from sales of (payments for purchase of) treasury stock	(755)	(675)	(1,028)	(1,918)	(0)
親会社による配当金の支払額	Payment of dividends by the parent company	(1,265)	(729)	(862)	(971)	(778)
その他	Others	(4)	10	(7)	(11)	(7)
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash and cash equivalents used in financing activities	(2,618)	(1,450)	(2,073)	(2,980)	(827)
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and equivalents	(624)	17	(171)	(146)	576
現金及び現金同等物の増加 (減少) 額	Increase (decrease) in cash and cash equivalents	1,169	3,740	1,626	(4,841)	2,429
現金及び現金同等物期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of year	9,729	10,899	14,639	16,265	11,579
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	Increase (decrease) in cash/cash-equivalent transactions due to changes in the accounting period of affiliated	—	—	—	155	—
現金及び現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at end of year	10,899	14,639	16,265	11,579	14,009

会社データ

Corporate Data

商号 Name	株式会社フジミインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED
設立年月日 Date of establishment	1953年(昭和28年)3月20日 March 20, 1953
資本金 Paid-in capital	¥4,753,438,500
上場市場 Securities traded	東京証券取引所第一部 Tokyo Stock Exchange (First Section) 名古屋証券取引所第一部 Nagoya Stock Exchange (First Section) 証券コード 5384 Code 5384
従業員数 Number of employees	783 (個別 Non-Consolidated 568)

役員 Board of Directors

2013年(平成25年)6月21日現在 (As of June 21, 2013)

代表取締役社長 President	関 敬史 Keishi Seki
常務取締役 Director	伊藤 広一 Hirokazu Ito
取締役 Director	土屋太加志 Takashi Tsuchiya
取締役 Director	鈴木 彰 Akira Suzuki
取締役 Director	大脇 寿樹 Toshiki Owaki
取締役 Director	鈴木 勝弘 Katsuhiko Suzuki
常勤監査役 Standing Corporate Auditor	石井 和廣 Kazuhiro Ishii
常勤監査役 Standing Corporate Auditor	松島 伸男 Nobuo Matsushima
監査役 Corporate Auditor	高橋 正彦 Masahiko Takahashi
監査役 Corporate Auditor	川下 政美 Masami Kawashita

事務所・拠点 Plants and Offices

本社・枇杷島工場 Headquarters・Biwajima Plant
〒452-8502
愛知県清須市西枇杷島町地鎮 2-1-1
Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166
1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi,
452-8502, Japan
Phone: +81-52-503-8181 Fax: +81-52-503-6166

稲沢工場 Inazawa Plant
〒492-8329
愛知県稲沢市西島町市助河戸 1-1
1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa, Aichi,
492-8329, Japan

各務原工場 Kakamigahara Plant
〒504-0927
岐阜県各務原市上戸町 7-1-8
1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara, Gifu,
504-0927, Japan

各務東町工場 Kakamihigashimachi Plant
〒509-0103
岐阜県各務原市各務東町 5-62-1
62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu,
509-0103, Japan

溶射材事業部 Thermal Spray Materials Department
〒509-0103
岐阜県各務原市各務東町 5-82-28
82-28, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu,
509-0103, Japan

研究開発センター R&D Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 1-8
8, Technoplaza-1, Kakamigahara, Gifu,
509-0109, Japan

物流センター Logistics Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 4-1
1, Technoplaza-4, Kakamigahara, Gifu,
509-0109, Japan

東京営業所 Tokyo Office
〒101-0047
東京都千代田区内神田 3-2-8 COI 内神田ビル 7F
7th Floor, COI Uchikanda Bldg., 2-8,
Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
101-0047, Japan

上海事務所 Shanghai Office
上海市浦東区科苑路 88 号、德国中心 317B 室
317B, German Center, 88 Keyuan Road,
Pudong Zhangjiang, Hi-Tech Park, 201203, Shanghai, China

関連会社 Affiliated Companies

フジミコーポレーション(米国)
FUJIMI CORPORATION
11200 SW Leveton Drive, Tualatin,
Oregon 97062, U.S.A.
Phone: +1-503-682-7822 Fax: +1-503-612-9721

フジミマイクロテクノロジー(マレーシア)
FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.
Unit 3, Level 15, Menara Genesis No. 33,
Jalan Sultan Ismail 50250, Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +60-3-2143-0036 Fax: +60-3-2145-8955

フジミヨーロッパ(ドイツ)
FUJIMI EUROPE GmbH
Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen, Germany
Phone: +49-7940-939499-0 Fax: +49-7940-939499-20

フジミ台湾(台湾)
FUJIMI TAIWAN LIMITED
No.10 Tongke 1st Rd., Tongluo Township,
Miaoli County 366, Taiwan (R.O.C.)
Phone: +886-37-987-123 Fax: +886-37-987-567

フジミ韓国(韓国)
FUJIMI KOREA LIMITED
RM1203 ParkView, Jungja-Dong 6, BunDang-Gu,
Seongnam-Shi, Kyeonggi-Do, Korea
Phone: +82-31-726-3555 Fax: +82-31-726-3556

株式情報 Stock Information

大株主一覽 Leading Shareholders

2013年(平成25年)3月31日現在 (As of March 31, 2013)

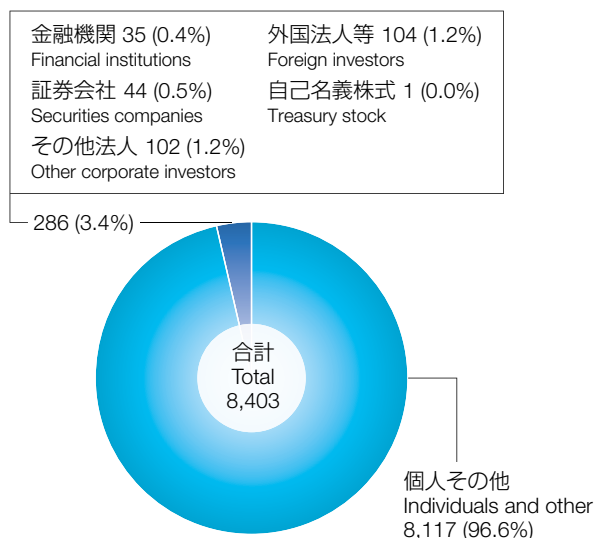
株主名 Name of Shareholder		所有株式数 (千株) Number of Shares Owned (Thousands of Shares)	持株比率 (%) Percentage of Total
株式会社フジインコーポレーテッド(自己株口)	Fujimi Incorporated (Treasury Stock)	4,760	15.5
越山 勇	Isamu Koshiyama	2,902	9.4
有限会社コマ	Koma Co., Ltd.	1,638	5.3
野田 純孝	Sumitaka Noda	1,520	4.9
日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust Account)	1,253	4.0
特定有価証券信託受託者ソシエテジェネラル信託銀行株式会社	Societe Generale Private Banking (Japan) Ltd. Designated Securities Trust	1,141	3.7
日本生命保険相互会社	Nippon Life Insurance Co.	779	2.5
株式会社三菱東京UFJ銀行	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	728	2.3
株式会社りそな銀行	Resona Bank, Ltd.	691	2.2
財団法人越山科学技術振興財団	The Koshiyama Science and Technology Foundation	600	1.9

(注) 所有株式数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てています。
Note: Shareholdings of less than 1,000 shares are omitted. Percentage shareholding is rounded off after the first decimal place.

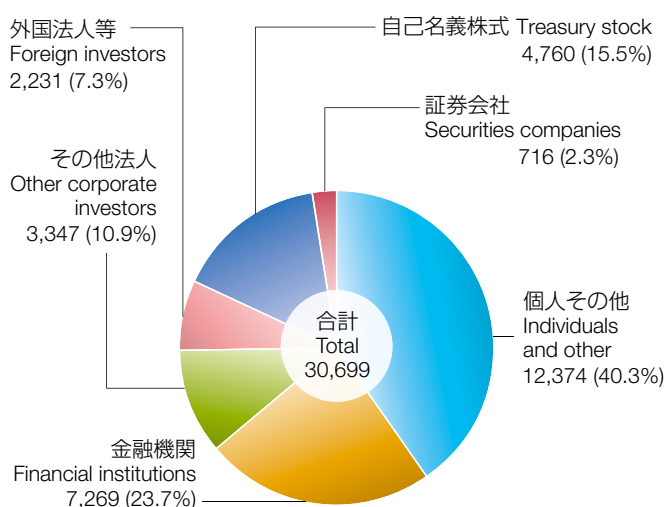
所有者別分布状況 Composition of Shareholders by Category

2013年(平成25年)3月31日現在 (As of March 31, 2013)

所有者別株主数(人)
Shareholders by Category (Number of Shareholders)



所有者別持株数(千株)
Shares Held by Shareholder Type (Thousands of Shares)



発行済株式の推移 Common Stock Issues

摘要 Type of Issue		発行済株式数(千株) Shares Outstanding after Issue (Thousands of Shares)	
1992年(平成4年)2月1日	February 1, 1992	第三者割当増資 Allotment of new shares to third parties	245
1992年(平成4年)11月20日	November 20, 1992	1株につき2株の株式分割(無償) 2-for-1 stock split	491
1993年(平成5年)9月27日	September 27, 1993	新株引受権の権利行使 Exercise of warrants	509
1994年(平成6年)5月20日	May 20, 1994	1株につき2株の株式分割(無償) 2-for-1 stock split	1,019
1994年(平成6年)8月4日	August 4, 1994	500円額面株式1株を50円額面株式 10株に分割 Exchange of 10 stocks with par value ¥50 for 1 stock with par value ¥500	10,195
1995年(平成7年)4月18日	April 18, 1995	一般公募増資 Public offering of common stock	10,995
1996年(平成8年)5月20日	May 20, 1996	1株につき1.1株の株式分割(無償) 1.1-for-1 stock split	12,094
1996年(平成8年)10月1日	October 1, 1996	一般公募増資 Public offering of common stock	12,894
1997年(平成9年)5月20日	May 20, 1997	1株につき1.1株の株式分割(無償) 1.1-for-1 stock split	14,184
1998年(平成10年)5月20日	May 20, 1998	1株につき1.1株の株式分割(無償) 1.1-for-1 stock split	15,602
2001年(平成13年)11月22日	November 22, 2001	自己株式の利益消却 Treasury stock purchased and retired	15,349
2005年(平成17年)5月20日	May 20, 2005	1株につき2株の株式分割(無償) 2-for-1 stock split	30,699

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド



古紙/リサイクル紙配合率5%以上再生紙を使用

この印刷物は、環境負荷低減のため適切に管理された古紙パルプを5%以上使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。

To reduce environmental impact, this publication was printed on environmentally responsible paper made with appropriately managed recycled pulp content of 5% or more, using vegetable ink to reduce emissions of volatile organic compounds (VOCs).

Copyright (C) 2013 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

Printed in Japan